

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成21年6月25日(2009.6.25)

【公開番号】特開2006-137954(P2006-137954A)

【公開日】平成18年6月1日(2006.6.1)

【年通号数】公開・登録公報2006-021

【出願番号】特願2005-331857(P2005-331857)

【国際特許分類】

C 09 J 201/00	(2006.01)
C 09 J 9/02	(2006.01)
H 01 B 1/22	(2006.01)
H 05 K 3/32	(2006.01)
H 05 K 3/36	(2006.01)
C 09 J 11/00	(2006.01)
C 09 J 121/00	(2006.01)

【F I】

C 09 J 201/00	
C 09 J 9/02	
H 01 B 1/22	D
H 05 K 3/32	B
H 05 K 3/36	A
C 09 J 11/00	
C 09 J 121/00	

【手続補正書】

【提出日】平成21年5月13日(2009.5.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

相対崎する回路電極を加熱、加圧によって、加圧方向の電極間を電気的に接続する加熱接着性接着剤において、前記接着剤中には、10μm以下の平均粒径で分散されたゴム粒子と、フィルム形成性高分子と、エポキシ樹脂と、潜在性硬化剤とを含有する回路接続用接着剤であって、

前記ゴム粒子は、平均粒径以下の粒子が粒径分布の80%以上を占めるシリコーン微粒子である回路接続用接着剤。

【請求項2】

相対崎する回路電極を加熱、加圧によって、加圧方向の電極間を電気的に接続する加熱接着性接着剤において、前記接着剤中には、硬化後に10μm以下の平均粒径で分散されているゴム粒子と、フィルム形成性高分子と、エポキシ樹脂と、潜在性硬化剤とを含有する回路接続用接着剤であって、

前記ゴム粒子は、平均粒径以下の粒子が粒径分布の80%以上を占めるシリコーン微粒子である回路接続用接着剤。

【請求項3】

DSC(示差走査熱分析)での発熱開始温度が60以上である、請求項1又は2に記載の回路接続用接着剤。

【請求項4】

硬化反応の80%が終了する温度が260である、請求項1～3のいずれか一項に記載の回路接続用接着剤。

【請求項5】

発熱量が50～140J/gである、請求項1～4のいずれか一項に記載の回路接続用接着剤。

【請求項6】

さらに0.2～30体積%の導電粒子を分散させた、請求項1～5のいずれか一項に記載の回路接続用接着剤。